

# 186 中等活性松香型液态助焊剂

## 产品概述

Kester 186,符合MIL-F-14256标准,被QPL核准为RMA型助焊剂.焊接后的残留物无腐蚀且不导电.186一直被用在焊接困难且工艺要求使用RMA型助焊剂的组装关键部位.186具有较高的热稳定性,很好的应用于需要较高预热温度或焊点长时间接触波峰的多层组件焊接.助焊剂残留不会导致表面绝缘阻抗的衰减.因为使用最少的活性离子以及残留物无活性的特性允许残留物残留在电路板表面.同时助焊剂残留也是耐湿与抗菌.

### 优点特征

- 高的热性能
- 优良焊接性能
- 按照J-STD-004标准,定义为ROL0型助焊剂
- 免除清洗的需要与费用

## RoHS 认证

Kester对于用户端使用有铅产品不决定其是否适用于任何RoHS豁免要求.

## 物理特性

**比重:** 0.879 ± 0.005  
Anton Paar DMA 35 @ 25°C

**固态含量(理论值):** 36%  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.34章节方法测试

**酸值(理论值):** 55.5 ± 7.8 mg KOH/g of flux  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.13章节方法测试

**闪点:** 18°C (64°F)

## 可靠性

**铜镜腐蚀:** 低  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.32章节方法测试

**铬酸银实验:** 通过  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.33章节方法测试

**氟化物点滴测试:** 通过  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35.1章节方法测试

**铜腐蚀测试:** 低  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.15章节方法测试

**氯,溴检测:** 0.02%  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35章节方法测试

**SIR检测:** 通过  
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.3.3章节方法测试

	空白处	186 板面朝下	186 板面朝上
第一天	5.0*10 <sup>9</sup> Ω	3.1*10 <sup>9</sup> Ω	5.2*10 <sup>9</sup> Ω
第四天	5.8*10 <sup>9</sup> Ω	4.9*10 <sup>9</sup> Ω	6.8*10 <sup>9</sup> Ω
第七天	6.3*10 <sup>9</sup> Ω	5.5*10 <sup>9</sup> Ω	7.2*10 <sup>9</sup> Ω

## 产品应用

Kester 186 能应用于电路板组装的发泡或者浸蘸工艺。当涂覆助焊剂后，建议使用风刀去除电路板上多于助焊剂，防止助焊剂滴落在预热区加热器表面。如果使用的喷涂系统能使用固态含量高达36%的助焊剂的话，186也能应用于喷涂工艺。

## 制程工艺管控

波峰焊传输速度应该调整到能满足焊点与波峰有足够的接触时间。一般来说Sn63Pb37要求焊点与波峰接触时间为2-4秒，无铅合金焊接要求焊点与波峰接触时间为4-8秒。调整预热设置至到能实现设定的预热温度。对于大多数电路板组装而言，最适宜的预热温度为90-105°C (194-221°F)，此为上板面或元件表面测量的温度，这个定义适用于所有合金。

## 助焊剂控制

比重(0.879 ± 0.005 Anton Paar DMA @ 25°C)是控制松香基型助焊剂浓度最普遍且最可靠的方法。检查浓度时，需要用到液体比重计。在使用过程中为了使电路板上助焊剂分布均匀，使用发泡系统容器来控制助焊剂使用量变得很重要。助焊剂中溶剂复杂的特性使得Kester 120稀释剂的使用变得势在必行，以补充溶剂挥发的损失。过多的电路板杂质，例如板子纤维及空气中微粒杂质，混入到助焊剂容器中，这些微粒将会再次沉积在电路板上，可能导致探针测试引脚上的残留增加。因此当过多杂质积累在助焊剂容器里面，清洗容器是有必要的，然后再补充新的助焊剂进去。

## 清洗

Kester 186 残留是不导电的，无腐蚀性，在大多数应用的情况下无需清洗。若需要清洗，请致电咨询Kester技术支持。

## 存储和保存期限

Kester 186是易燃性的，请远离火源存储。在10-25°C (50-77°F)条件下合理存储，保存期限为1年。

## 健康与安全

本产品在操作和使用过程中，可能会对健康或环境造成危害。请在使用本产品前，阅读材料安全说明书和警示标签。